



LCYtech.

李長榮科技股份有限公司 法人說明會

股票代號：4989.TW

2025/09/30

免責聲明

- 本簡報合併財報數字係根據國際財務報導準則編製，並經由會計師查核或核閱。
- 本簡報中可能包含對產業及前景之預測，係基於對現況之預期，但可能同時受限於已知或未知風險與不確定性影響。因此實際結果將可能明顯不同於所陳述之內容。
- 除法令要求外，本公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述。
- 本簡報資料不得視為買賣有價證券或其他金融商品之要約或要約之引誘。
- 本簡報資料之著作權歸本公司及本公司關係企業所有，不得直接或間接複製或傳送給任何第三人，且不得為任何目的出版刊印。

目錄

LCYtech.

1.公司簡介

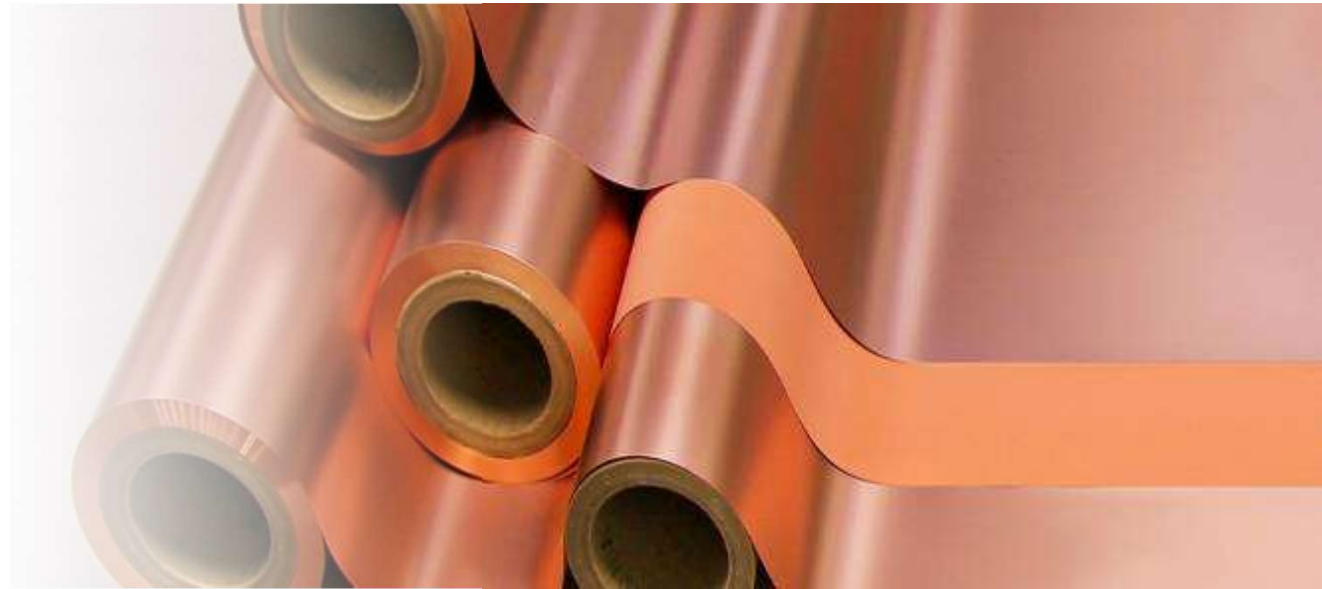
2.產業概況

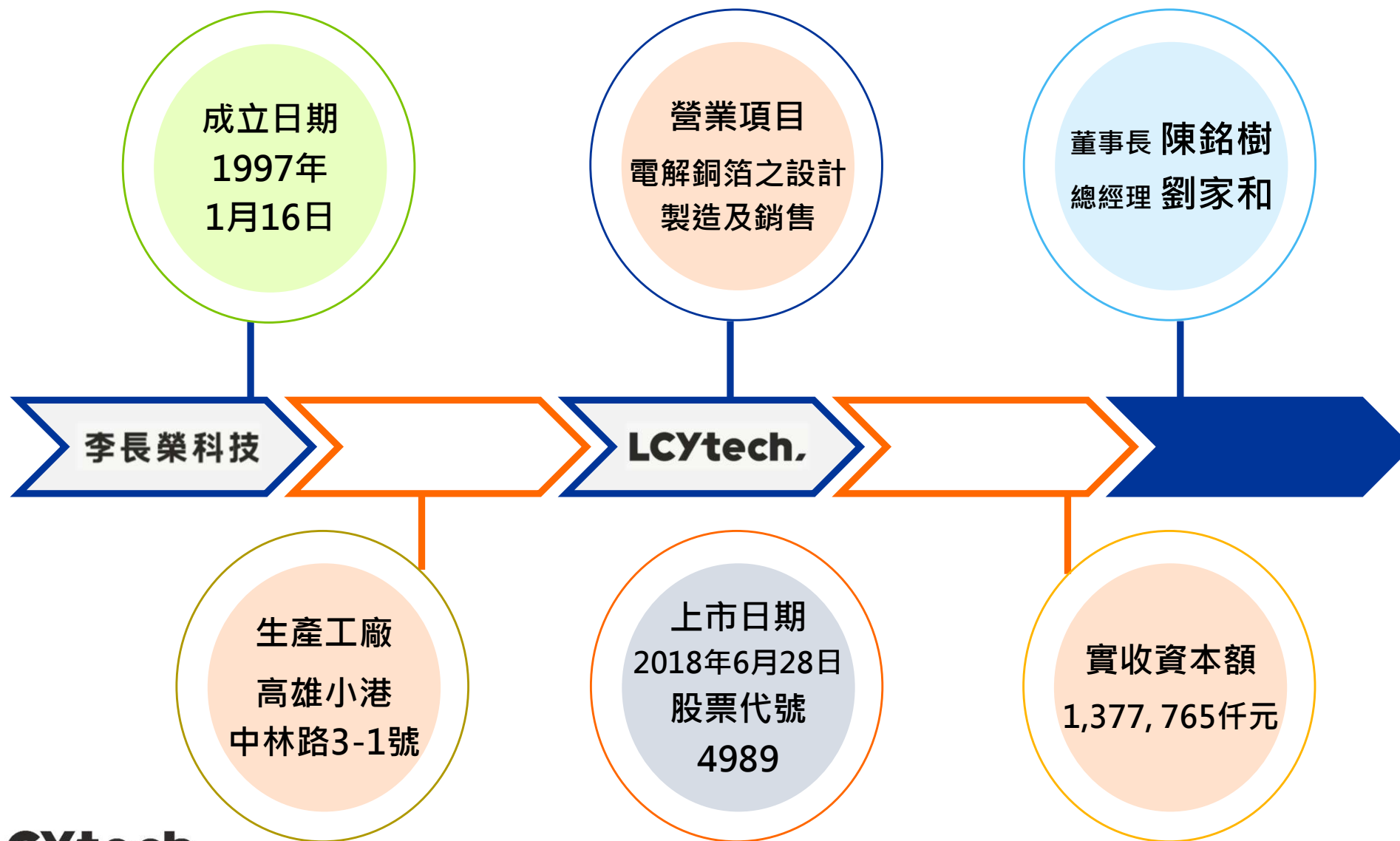
3.營運報告

4.技術製造永續發展

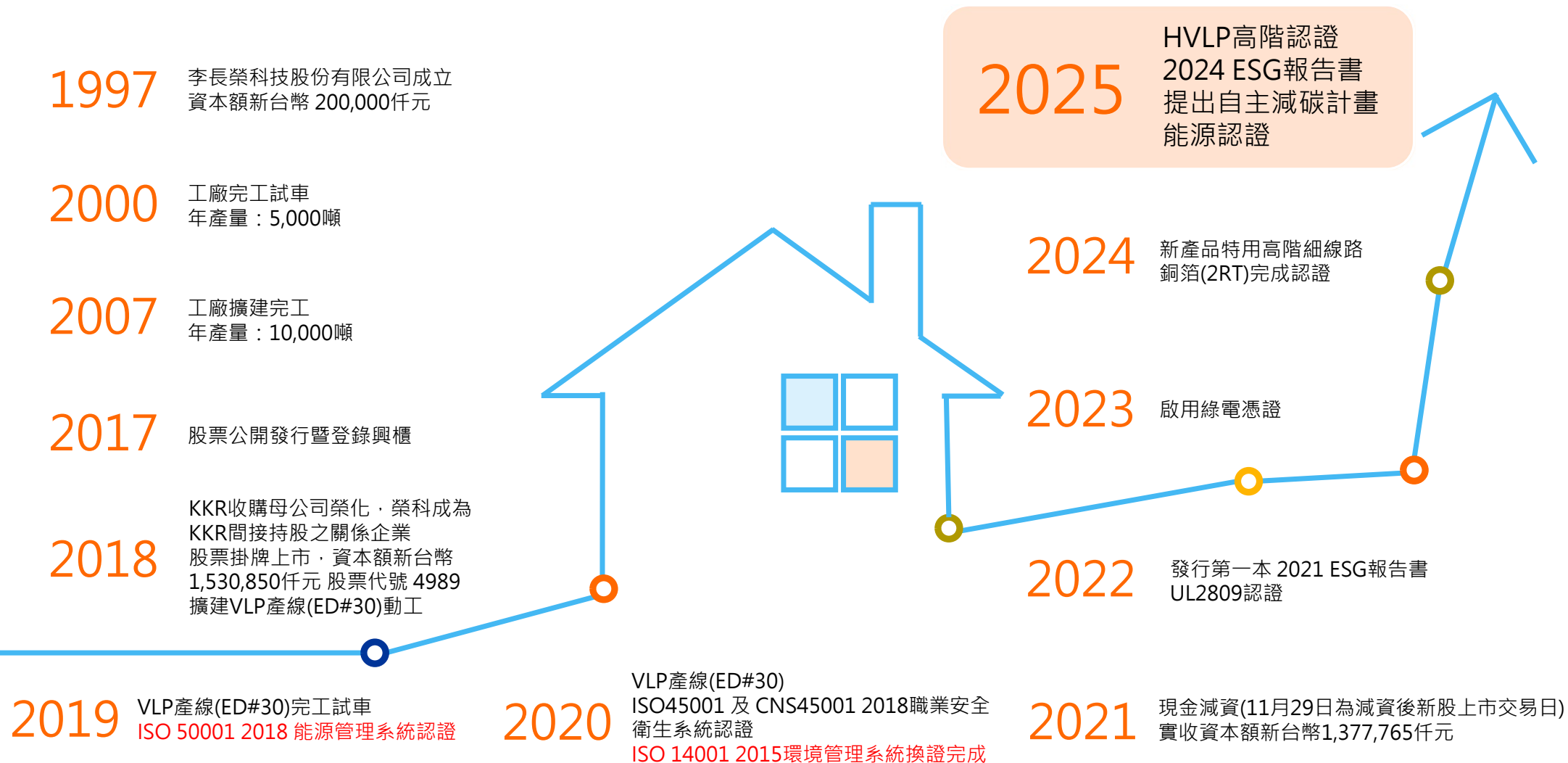
5.Q & A

公司簡介





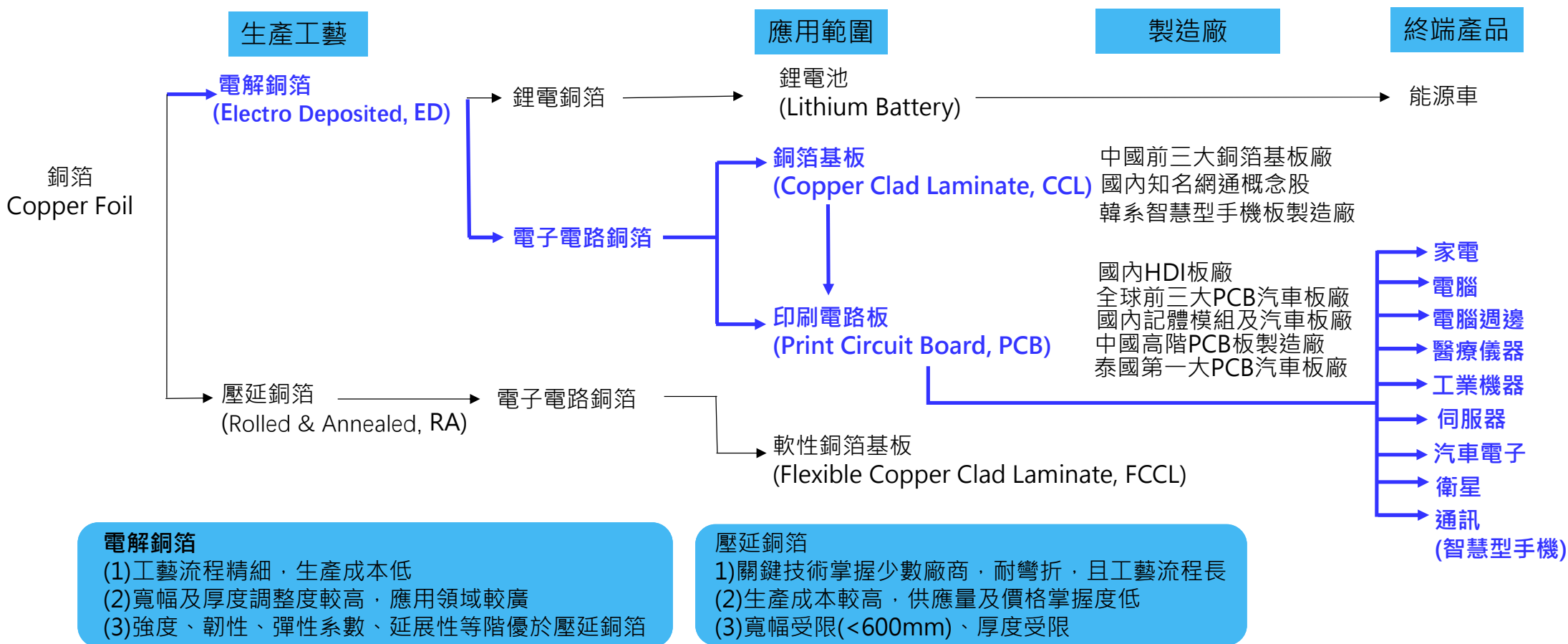
LCYtech,



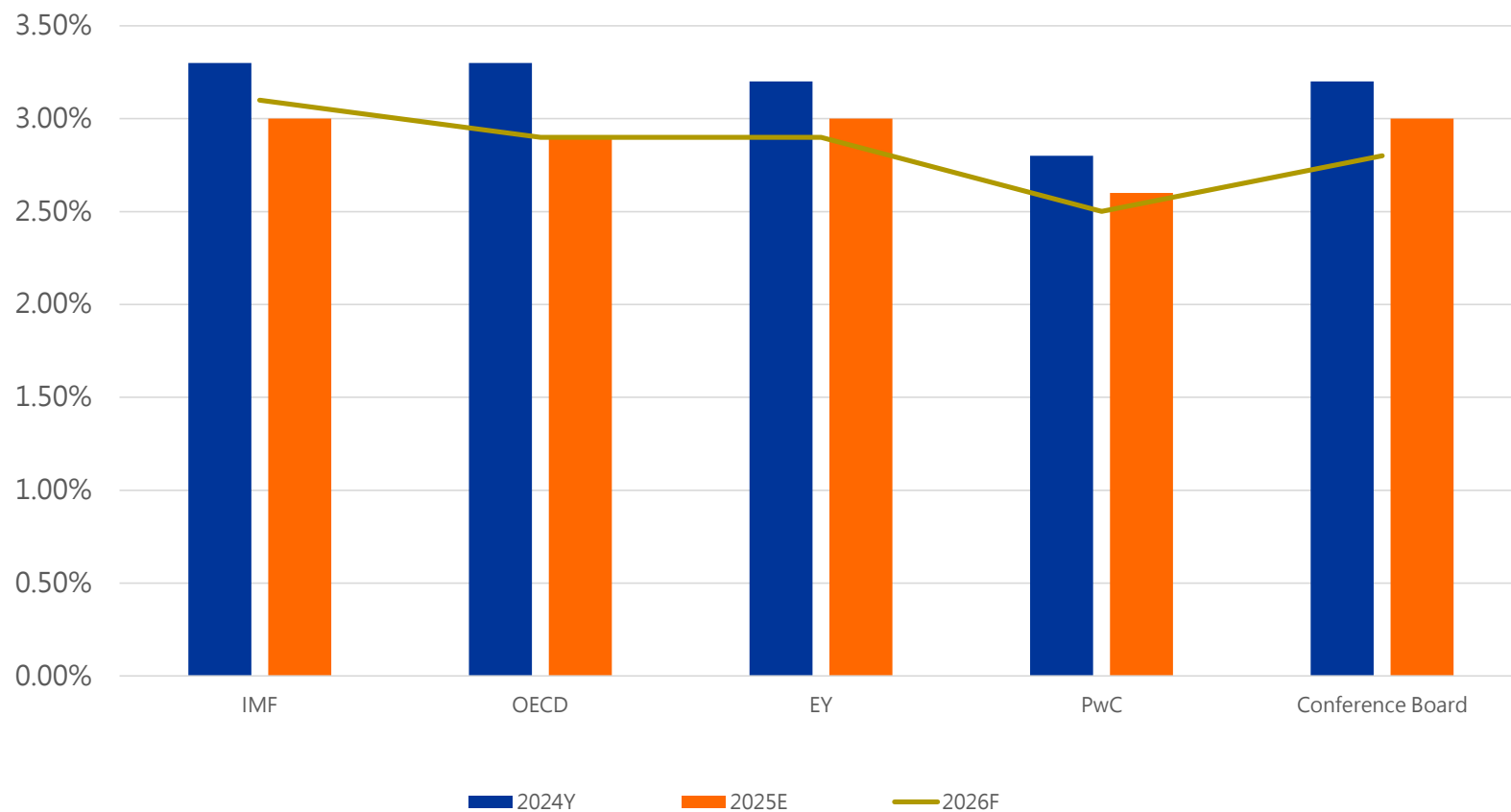
產業概況



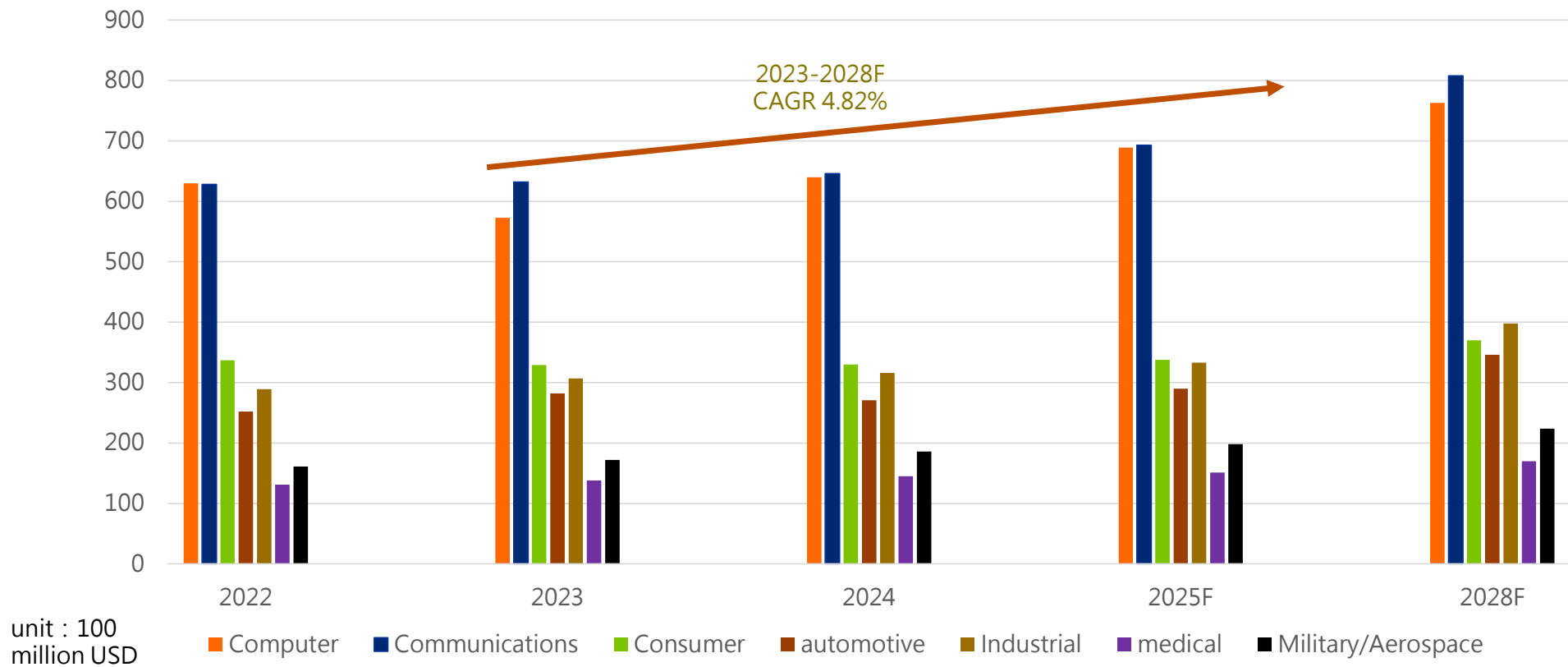
銅箔產業



產業概況_全球經濟景氣預測



電子業_終端應用趨勢



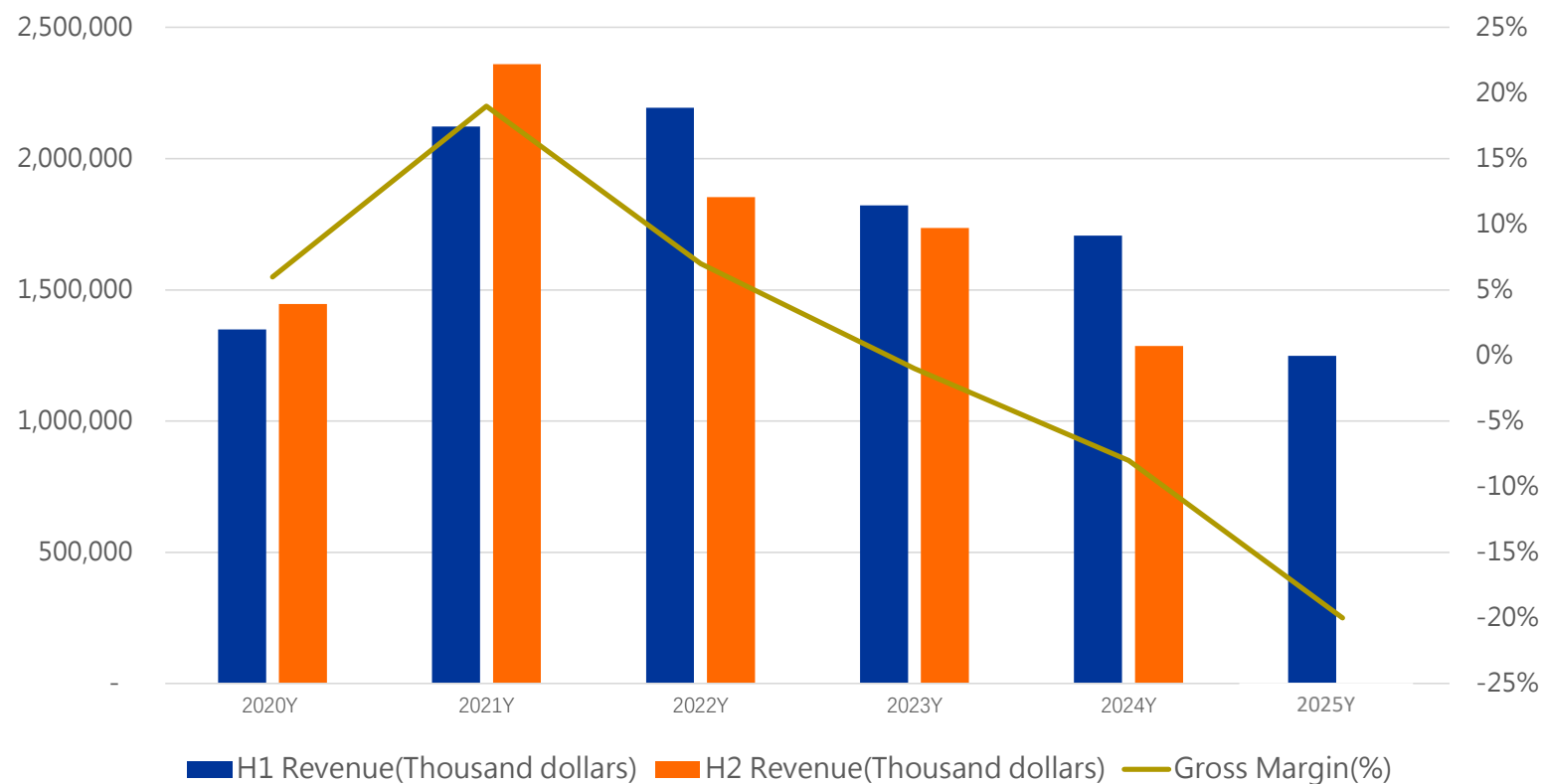
資料來源：Prismark

營運報告



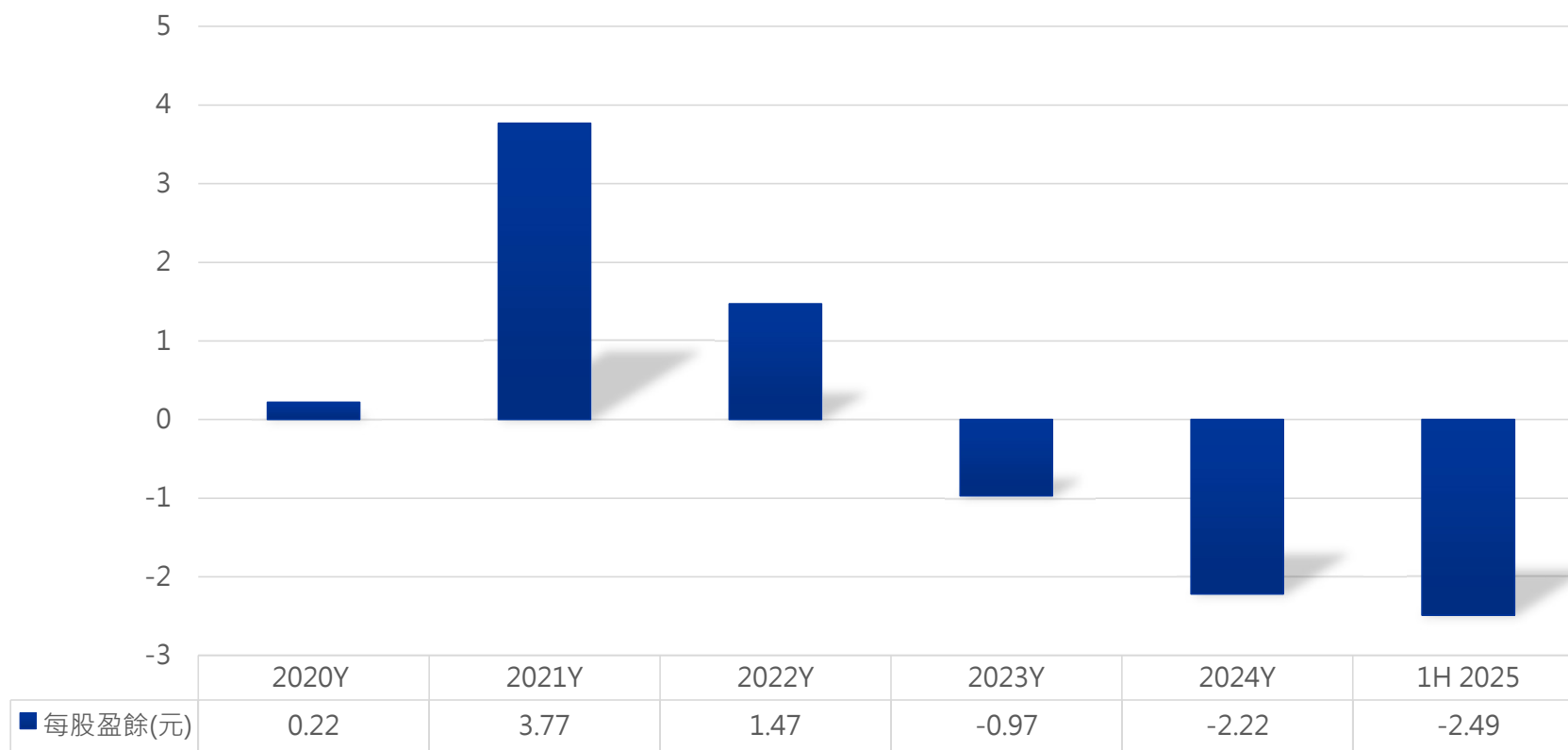
營運報告

歷年同期營收及當期毛利率趨勢



營運報告

歷年及當期每股盈餘



營運報告_簡明損益表(合併)

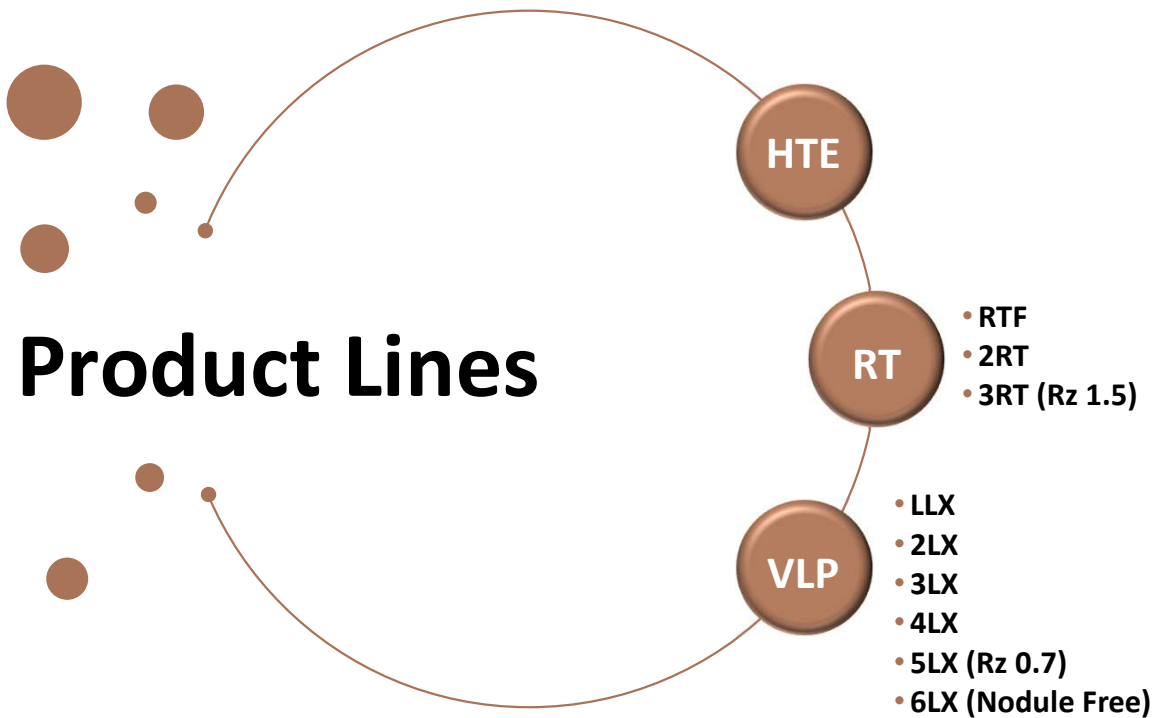
單位：新台幣千元 / 股利及EPS為元

項目	2024年		2025年第一季		2025年第二季	
營業收入	2,993,614	100%	506,900	100%	742,393	100%
營業成本	3,246,752	108%	583,142	115%	919,443	124%
營業毛利	-253,138	-8%	-76,242	-15%	-177,050	-24%
營業費用	155,008	5%	31,499	6%	33,504	5%
營業損利	-408,146	-13%	-107,741	-21%	-210,554	-29%
營業外支出	99,391	3%	14,348	3%	-60,874	-8%
稅前損益	-308,755	-10%	-93,393	-18%	-271,428	-37%
稅後損益	-305,228	-10%	-91,504	-18%	-251,985	-34%
每股盈餘(元)	-2.22		-0.66		-1.83	
現金股利(元)	0		-		-	

技術製造 永續發展

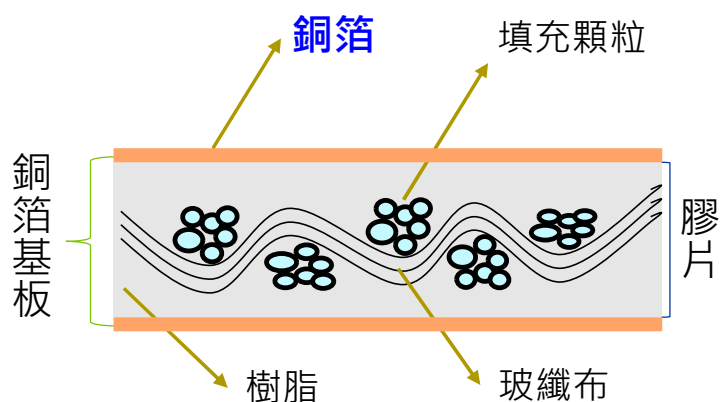


LCYT 銅箔產品組合



	Thickness (μm)								
	8	9	12	15	18	35	70	105	140
HTE									
	(Pilot)								
RTF									
2RT									
3RT									
	(Pilot)								
LLX									
2LX									
3LX									
	(Pilot)								
4LX									
5LX									
6LX									
	(RD)								

高階銅箔關鍵製程



圖片來源：工研院(2020/8)

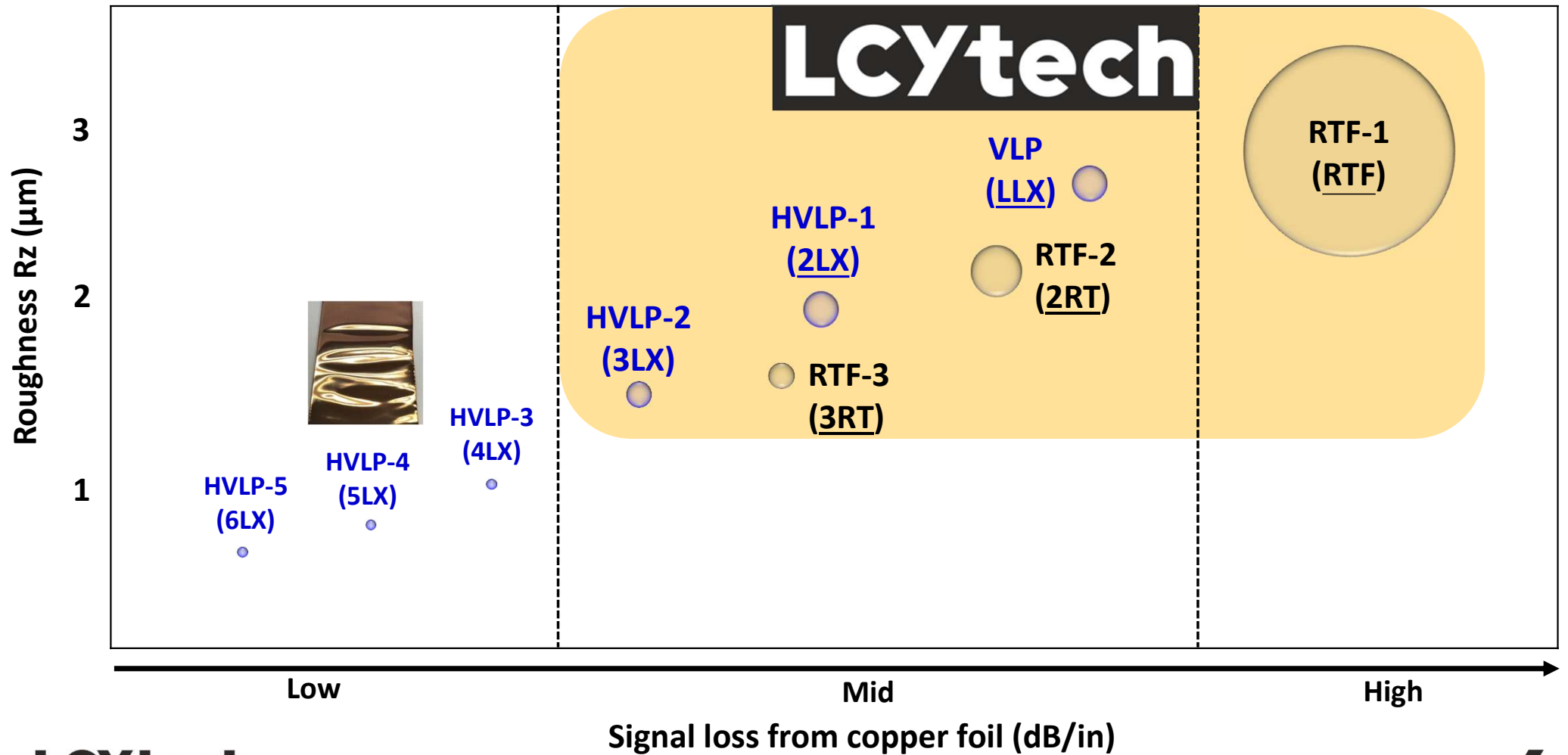
決定訊號傳輸品質的重要因子

- 表面形貌(粗糙度)
- 材料特性(表面處理)

銅箔粗糙度對照表

處理面粗糙度 (μm)	常規銅箔 Standard HTE foil	反轉銅箔 RT-series	超低粗糙度銅箔 VLP-series	高頻應用
Rz≥4	low-profile class 3 PK-HTE-LP3	-	-	佳
Rz≤4	-	RTF1 level PK-HTE-RTF	VLP level BR-DSS-LLX	
Rz≤2.3	-	RTF2 level PK-HTE-2RT	HVLP1 level BR-DSS-2LX	
Rz≤1.5	-	RTF3 level PK-HTE-3RT	HVLP2 level BR-DSS-3LX	
Rz<0.8	-	-	HVLP4 level BR-DSS-5LX	

RTF 與 HVLP 概況



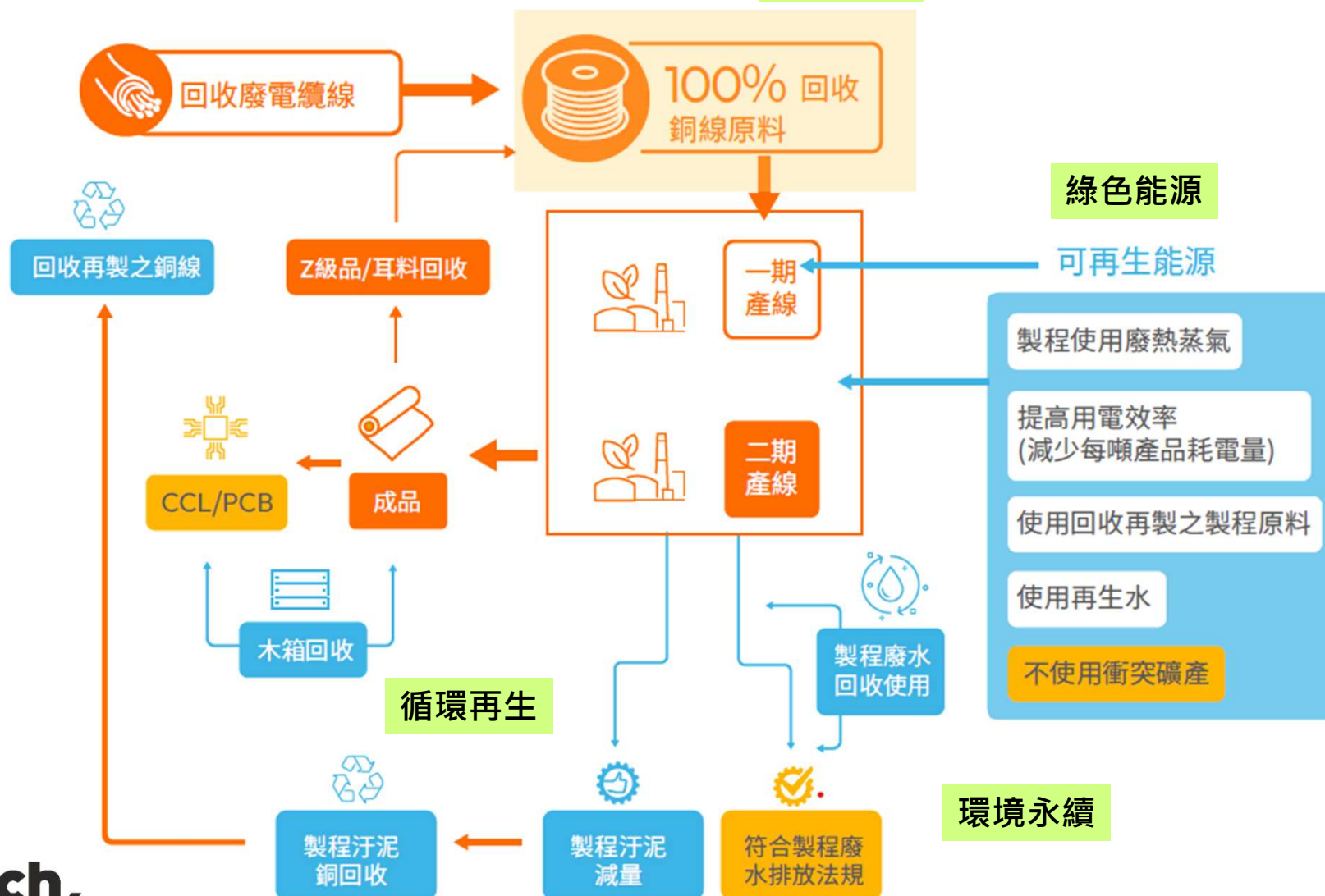
RTF 銅箔開發與應用

RTF level (市場定義)	RTF	RTF2	RTF3
粗糙度(μm)	$Rz \leq 4$	$Rz \leq 2.3$	$Rz \leq 1.5$
LCYT 牌號	RTF	2RT	3RT
LCYT	通過認證 客戶逐步放量		通過第一階段 客戶認證
終端產品	HDI, Server	Smart phone, LEO Satellite	HPC Server

高階 HVLP 銅箔開發與應用

HVLP level (市場定義)	VLP	HVLP	HVLP2	HVLP3	HVLP4 (nano nodule)	HVLP5 (nodule free)
粗糙度(μm)	<2.5	<2	<1.5	<1	<0.8	<0.5
LCYT 牌號	LLX	2LX	3LX	4LX	5LX	6LX
LCYT	通過認證 + 部分測試送樣 Trial Order			測試送樣		開發中
終端產品	RFID	AI PC & server		AI PC & server (Next Generation)		Niche

UL 2809



製程優化主要項目

AI預測生產模型，時時監控
即時調整，最佳化生產結果

設備 優化

1. 高階銅箔去瓶頸工程
2. AICCD 升級
3. 銅液回收



節電 節水

1. 部署政府節電政策
2. 優化設備節電
3. 使用再生水
4. 啟用綠電憑證



智慧 製造



LCYT 永續 6R

◆ 安全取代 (Replace)

製程管理符合
國際規範

◆ 能源回收 (Recycling)

使用中鋼製程排出
之廢熱蒸氣

◆ 循環回收 (Recovery)

水資源循環

◆ 可再生 (Renewable)

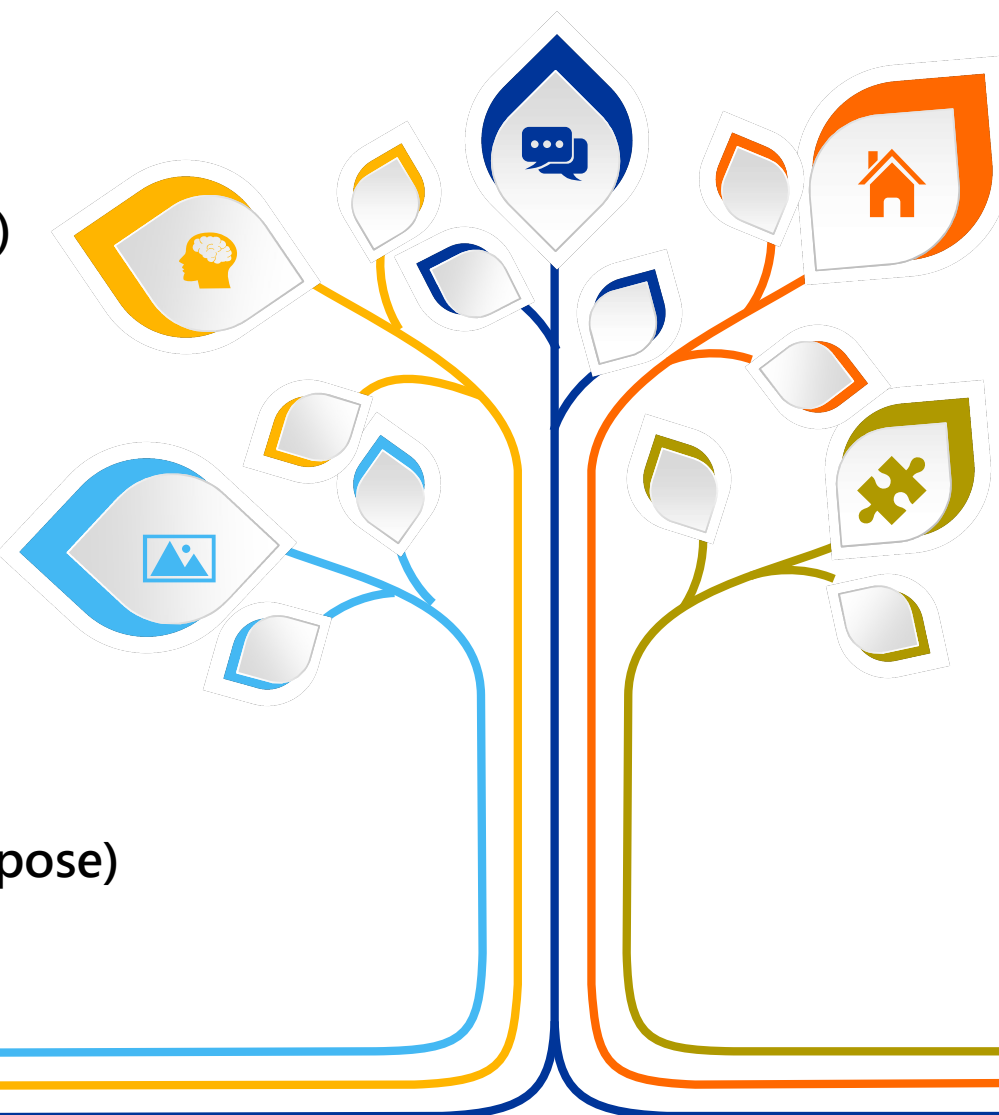
可再生硫酸銅溶液

◆ 減量 (Reduce)

減少廢棄物

◆ 賦予新用途 (Repurpose)

污泥再利用處理



Our Mission

Accelerate Innovative Science for a Sustainable Future

Q & A

- ◆董 事 長：陳 銘 樹 Paul Chen
- ◆發 言 人：劉 家 和 Justin Liu
- ◆代理發言人：蔡 孟 修 Berry Tsai
- ◆聯 絡 電 話：(02)2763-1611
- ◆聯 絡 信 箱：lcyt@lcygroup.com
- ◆公 司 資 訊：lcyt.lcycic.com
- ◆股 票 代 號：4989.TW

LCYtech.

李長榮科技股份有限公司

台北市松山區八德路四段 83 號 5 樓

股票代號：4989.TW

公司資訊：<https://lcyt.lcycic.com/>